

2023 年度日本セラミックス協会 資源・環境関連材料部会講演会
「世界に誇る日本のセラミックス焼結体技術」

我が国のセラミックス焼結体製品には大きな世界シェアを占めるものがいくつもあります。そのような焼結体技術を支える研究者の方々から最新の研究動向を解説いただきます。

【共催】 日本セラミックス協会資源・環境関連材料部会,
(地独) 東京都立産業技術研究センター

【協賛】(予定を含む) 日本化学会, 応用物理学会, 電気化学会,
日本ファインセラミックス協会, 日本粘土学会, 無機マテリアル学会,
粉体粉末冶金協会, 粉体工学会, ナノ学会

【日時】 2023 年 10 月 18 日 (水) 13:00~19:00

【場所】 東京都立産業技術研究センター本部イノベーションハブ
(135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL 03-5530-2111 (代表)
ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前)

【プログラム】

- 13:00 ~ 13:10 開会の辞 日本セラミックス協会資源・環境関連材料部会長 樽田誠一
- 13:10 ~ 13:20 挨拶及び都産技研の紹介 東京都立産業技術研究センター (調整中)
- 13:20 ~ 14:10 住友化学株式会社エネルギー・機能材料研究所 無機材料グループ
尾崎大智氏 「高純度アルミナの新規技術開発と用途展開」
- 14:10 ~ 15:00 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (中部センター) 堀田幹則氏
「セラミック成形プロセスの最新技術
~3D 積層造形およびその関連プロセス~」
- 15:00 ~ 15:15 休憩
- 15:15 ~ 16:05 横浜国立大学教授 大学院環境情報研究院 多々見純一氏
「OCT を利用したセラミックスの焼結挙動のオペランド観測
~焼結体内部にあらわれる不均質構造のその場可視化~」
- 16:05 ~ 16:55 香川大学教授 創造工学部創造工学科 楠瀬尚史氏
「液相焼結を利用したセラミックスの熱伝導および電気抵抗に
関する研究」
- 16:55 ~ 17:00 閉会の辞 講演会担当主査 安藤和人
- 17:10 ~ 19:00 意見交換会 (近くの会場選定中) 講師および参加者による意見交換

【定員】 50名予定

*定員に達しましたら締め切り前でも受け付けを終了します。

【参加申し込み方法】 参加申し込み締め切り：2023年9月29日（金）

下記の項目①～⑥を本文に明記し、E-mail（件名は「2023 講演会参加申し込み 参加者氏名」としてください。）を申込用アドレス宛へお送りください。

参加申込用アドレス：mishitsuka@soc.co.jp

- ① 参加者氏名（フリガナ）、② 参加者所属、③ 参加者区分（一般あるいは学生）、
 - ④ 連絡先（E-mail アドレス）、⑤ 意見交換会への参加有無
 - ⑥ 参加費のお振込み予定日、
- （複数名の参加費を同時振込する場合はその旨もお知らせください。）

【参加費】 2023年10月6日（金）までに下記の振込先へご送金ください。

（消費税込み）	一般	学生
講演会（10/18）	5,000 円	2,000 円
意見交換会（10/18）	4,000 円	4,000 円

*協賛会員、非会員（一般、学生）の方も上記と同様です。

*参加費（講演会・意見交換会とも）の当日支払いはできません。

*講演予稿集は事前に Web 配布いたします。

【振込先】 参加申込を済ませてからお振りこみ下さい。

ゆうちょ銀行（口座名義）資源・環境関連材料部会

（読み：シゲン・カンキョウカンレンザイリョウブカイ）

[ゆうちょ銀行から] 記号 14060 口座番号: 36752161

[他の金融機関から] 店名 四〇八（ヨンゼロハチ）店番 408 普通口座: 3675216

*振込受領書を領収書にかえさせていただきます。

*振込用紙での現金振込には非対応となります。

*請求書の必要な方は別途お申し出ください。ただし、電子ファイルでの対応のみといたします。

*ご送金いただいた後、取り消しによる返金は致しません。

【問い合わせ先】 日本セラミックス協会 資源・環境関連材料部会担当幹事

住友大阪セメント株式会社新規技術研究所企画グループ 石塚雅之

T E L : 047-457-0195、E-mail : mishitsuka@soc.co.jp